

## 特点:

- 频率范围: 10MHz~500MHz
- 插入损耗:  $\leq 0.5\text{dB}$
- 方向性:  $\geq 11\text{dB}$
- 接口形式: SMD 封装
- 尺寸:  $8.30 \times 6.35 \times 4.50\text{mm}$

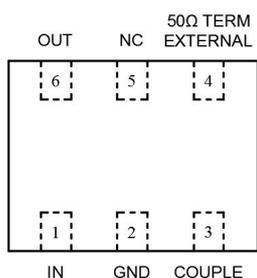
## 图片:



## 性能参数: (50Ω系统, $T_A = -55^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$ )

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f		10~500			MHz	
耦合度	Cou	$P_{IN}=0\text{dBm}$ f=10MHz~500MHz	24.5	26.0	27.5	dB	
耦合平坦度	$\Delta\text{Cou}$		$\pm 0.9$	$\pm 1.2$	dB		
插入损耗	IL	$P_{IN}=0\text{dBm}$ f=10MHz~100MHz		0.15	0.35	dB	
		$P_{IN}=0\text{dBm}$ f=100MHz~250MHz		0.2	0.3	dB	
		$P_{IN}=0\text{dBm}$ f=250MHz~500MHz		0.3	0.5	dB	
方向性	Dir	$P_{IN}=0\text{dBm}$ f=10MHz~100MHz	22	35		dB	
		$P_{IN}=0\text{dBm}$ f=100MHz~250MHz	16	25		dB	
		$P_{IN}=0\text{dBm}$ f=250MHz~500MHz	11	18		dB	
输入驻波比	VSWR <sub>i</sub>	$P_{IN}=0\text{dBm}$ f=10MHz~500MHz		1.10:1	1.25:1		
输出驻波比	VSWR <sub>o</sub>			1.10:1	1.25:1		
耦合端驻波比	VSWR <sub>c</sub>			1.10:1	1.50:1		

## 功能框图:



顶部透视图

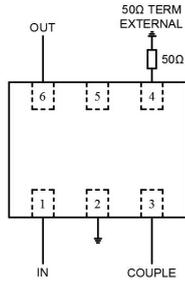
## 引脚定义:

引脚编号	符号	描述
1	IN	射频输入端口, DC 耦合
6	OUT	射频输出端口, DC 耦合
3	COUPLED	耦合输出端口, DC 耦合
2	GND	接地
4	50Ω TERM EXTERNAL	外接 50 Ohm
5	NC	悬空

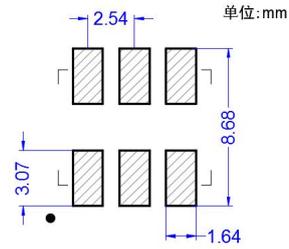
## 极限参数表:

参数名称	极限值
功率容量	平均功率 5W
装配温度	+260°C, 20s
工作温度	-55°C~+85°C
贮存温度	-55°C~+100°C

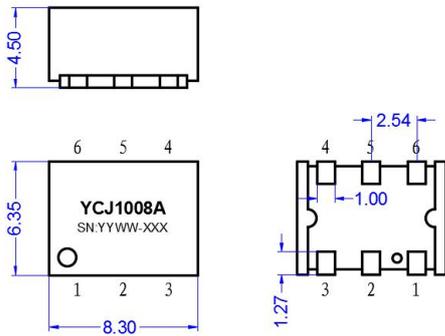
### 推荐外围电路:



### 推荐焊盘:



### 外形尺寸图:

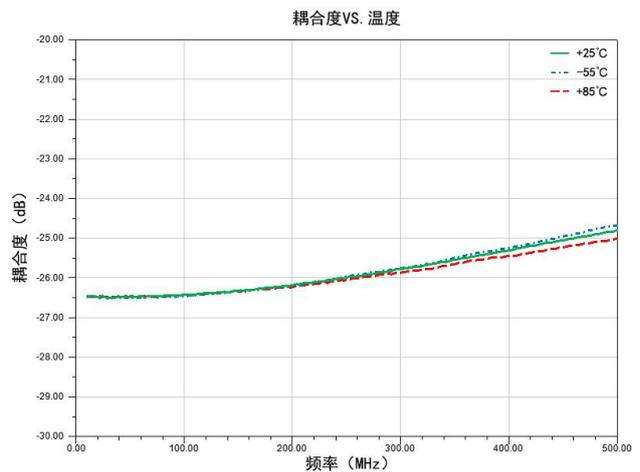
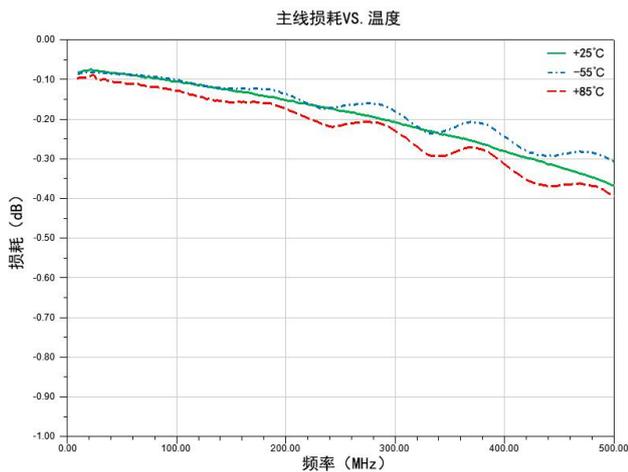


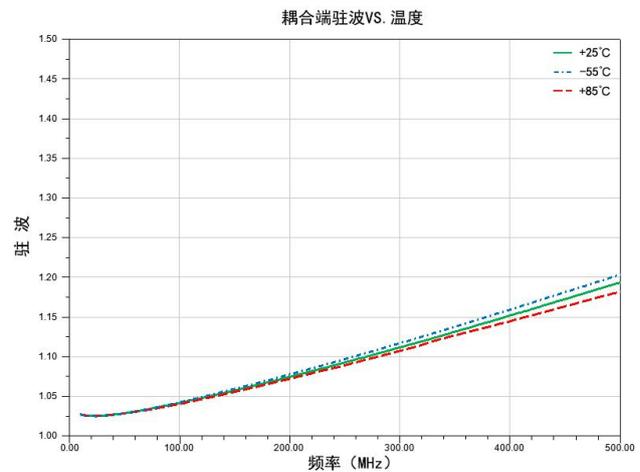
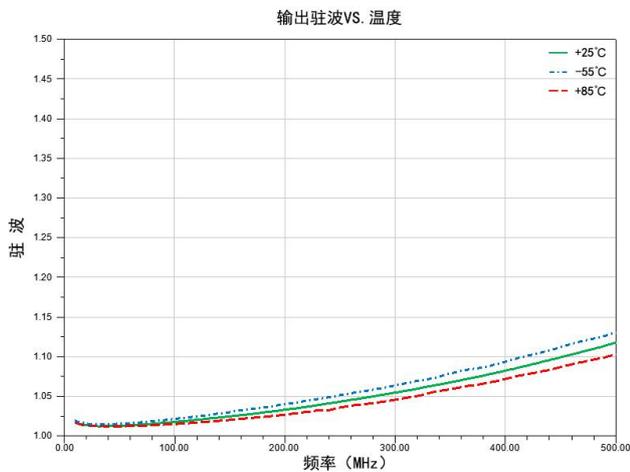
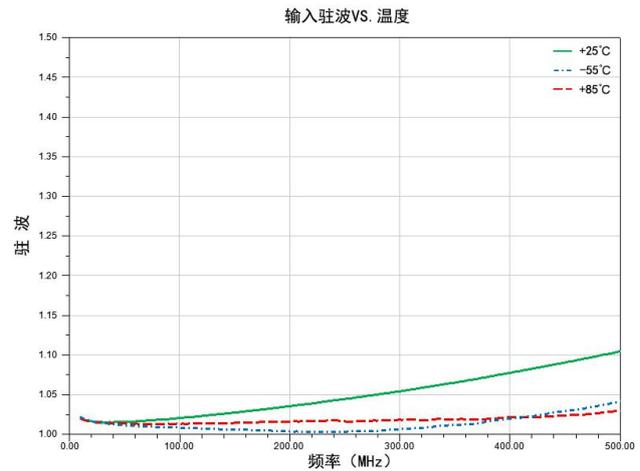
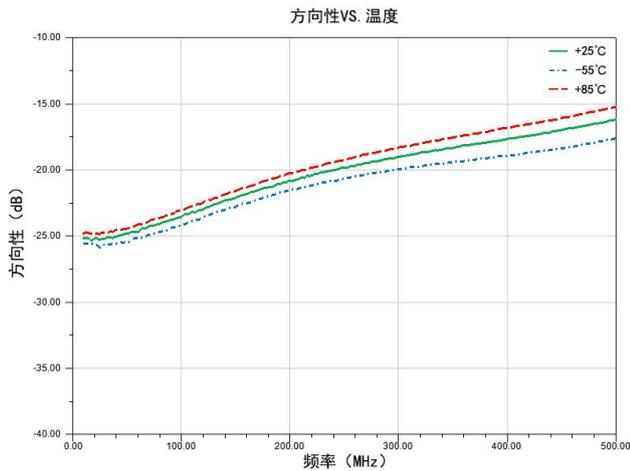
### 字符标志:

标识	说明	备注
YCJ1008A	产品型号	
YYWW	批次号	
XXX	序列号	

- 注: 1、单位: mm, 未标注公差按±0.2mm;  
2、产品采用陶瓷封装;  
3、产品采用激光刻字标识。

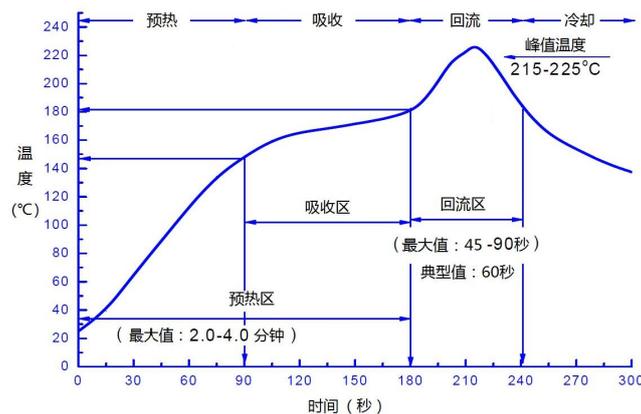
### 典型测试曲线(50Ω系统, $P_{IN}=0dBm$ ):





### 产品使用注意事项:

1. 产品使用时请保证接地良好 (GND 引脚);
2. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用, 采用 Sn63/Pb37 锡膏, 熔点+183℃回流焊接, 回流温度推荐曲线。



3. 此图为推荐回流温度曲线, 因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线, 实测回流基板温度不得超过极限参数中的装配温度。
4. 如特殊情况需采用手工补焊, 烙铁温度+350℃, 焊接时间不超过 3 秒; 回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装, 存放条件: 温度+10~+35℃, 湿度 35~65%RH; 对于需长期储存 (超过半年) 产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境, 客户在对产品焊接及清洗完成后, 应对产品进行三防喷涂处理, 以提高产品耐环境适应性能力。